

ASMPT enabling the
digital world



DEK TQ印刷平台

为智慧工厂提供极致质量和最佳性能

DEK TQ印刷平台

最高质量和性能

配合高灵活性

超快，异常精确，真正节省空间——数字不言自明：核心周期时间从5到6.5秒，湿印精度为 ± 17.0 微米@ 2 CpK，占地面积从1.3到1.95平方米。最大的灵活性得益于两个版本：DEK TQ对应板尺寸达400毫米× 400毫米，DEK TQ L对应板尺寸达600毫米× 510毫米。

这台机器之所以能达到如此惊人的速度，部分原因在于它的3段式传输和它独特的带有光纤线路的NuMotion控制器。新开发的驱动器，未接触皮带的印刷和创新的夹紧系统确保了新的精度水平和极其稳定的印刷工艺——通过ASMPT认证，因为每台机器的精度在交货前都进行了测量和记录。

使用双门盖板，在不停止印刷下更换锡膏管、在自动智能顶针和一系列更智能的功能支持情况下，印刷机平均运行超过8小时无需任何用户辅助。与SPI系统的闭环连接保证了最大效率。

该印刷机平台与开放式自动化概念无缝结合，并提供IPC-HERMES-9852和IPC-CFX板相关的M2M和M2H通信，并与MES，ERP和AIV车队管理系统无缝集成。此外，在智慧工厂中，广泛的选项可以实现更程度的锡膏印刷自动化。



DEK TQ

创新



新开发的USC (钢网底部清洁)

采用超大的布卷，易于替换的清洁主体，新的分配清洁液系统。易于替换的擦拭纸卷宽。



创新的印刷头

集成的锡膏高度监控和新改进的刮刀压力控制，更快更准确。



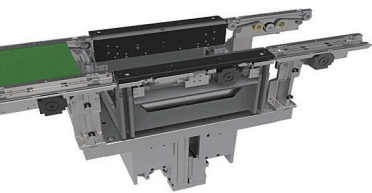
智能顶针支撑

自动和灵活的支撑设置顶针与验证顶针的位置和高度，减少手动辅助。

DEK TQ为您带来 竞争优势

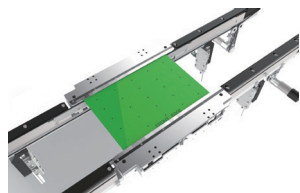


凭借其众多接口标准，DEK TQ印刷机平台可以无缝地融入集成智慧工厂，同时其越来越多的选项可以自动化换产设置，并最大限度地减少操作员的协助。



线性驱动器, 夹紧系统和创新的传输导轨

标准的3段式传输导轨，采用未接触皮带印刷，确保更快更稳定的印刷工艺。



DEK通用夹具 (APC)

通用和灵活的夹紧系统，自动适应板的形状和厚度，是倚靠于软件控制的线性驱动器。

最高印刷质量

新型未接触皮带印刷夹紧工艺，创新的印刷头和驱动器，以及钢网的全区域气动夹紧



最大精度

湿印精度高达 $\pm 17.5 \mu\text{m}$ @ 2 Cpk，焊膏印刷用于0201公制元器件



最大产量

核心周期：5秒 (DEK TQ)
6.5秒 (DEK TQ L)



快速的3段式传输

线性驱动、创新的夹板系统、未接触皮带印刷、NuMotion控制器



运行8小时而无需协助

钢网擦拭器采用22米的布卷和7升的清洁液，自动锡膏管理和自动智能顶针系统



开放、易于集成

IPC-Hermes-9852、到SPI采用闭环控制、WORKS OIB、IPC CFx



有效的编程

新的直观软件和WORKS软件离线编程



最佳的占地面积性能

占地面积仅1.3平方米 (DEK TQ)
1.95平方米 (DEK TQ L)



背靠背

双轨传输生产线完美的解决方案



关于DEK TQ的更多信息，请扫描



DEK TQ印刷平台



设备类型	DEK TQ	DEK TQ L
标准配置	规格	
设备对位能力	> 2.0 cmk @ ±12.5 microns (±6 sigma)	
湿印精度	> 2.0 cmk @ ±17.0 microns (±6 sigma)	
最短核心周期	5秒	6.5秒
最大印刷区域	400 mm (X) × 400 mm (Y)(单段模式)	560 mm (X) × 510 mm (Y) (单段模式) 560 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板)
设备控制	NuMotion控制系统	
轴驱动	每个线性驱动器配有高精度编码器，用于相机轴和钢网清洗	
刮刀压力机构	软件控制、闭环反馈驱动	
钢网定位	自动加载定位含刮刀滴盘	
最小基板尺寸	50 mm (X) × 50 mm (Y)	50 mm (X) × 50 mm (Y)
最大基板尺寸	250 mm (X) × 400 mm (Y)(3段模式) 400 mm (X) × 400 mm (Y)(单段模式)	300 mm (X) × 510 mm (Y) (3段模式) 600 mm (X) × 510 mm (Y) (单段模式) 400 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板 - 3段模式)* 600 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板 - 单段模式)*
大概尺寸	1000 mm x 1300 mm x 1600 mm (长×宽×高)	1300 mm x 1500 mm x 1600 mm (长 x 宽 x 高)
选项		
自动智能顶针支撑	30顶针匣(4毫米和12毫米顶针)	高达60顶针匣(4毫米和12毫米顶针)
DEK锡膏管理	自动锡膏添加偕同自动锡膏卷高度控制应用	
双门盖板	无需印刷机和生产线停止，就能简单替换锡膏管/罐	
DEK通用夹具	灵活和完全软件控制的垂直和横向夹紧	
高流量真空	特殊的大面积真空系统包括灵活的治具组，是载具的理想选择	
闭环链接到SPI系统	ProDEK扩展锡膏控制	

* 超过380mm (X)的板材将需要GridLok模具或专用模具板。

ASMPT

先进装配系统有限公司

上海市东育路227弄3号前滩世贸中心二期C栋3层 | 电话: +86 21 58873030 | E-mail: smt-solutions.cn@asmpt.com

asmpt.com | smt.asmpt.com

8/07-2024版 | 保留所有权利 | 订购号: A22-ASMPT-A310-ZH | 中国印刷 | ©ASMPT GmbH & Co.KG

本手册中的所有信息和插图均以“概不保证”的方式提供，不含任何明确或隐含的担保，包括但不限于对质量满意、适用于特定用途和/或正确性的隐含担保。

本手册的内容仅供参考，不构成建议，如有更改，恕不另行通知。ASMPT在法律允许的最大范围内，对本手册中包含的内容、细节、规格或信息的正确性、准确性、充分性、实用性、及时性、可靠性或其他方面的使用不作任何保证或声明。请联系ASMPT以获取最新信息。仅在达成协议的情况下，特定性能特性和/或功能才具有法律效力。

所有产品名称均为ASMPT或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。